600584

Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.

A

ك

5 كلا

12 جم

جم

فى

جه

/ / /		
/		2013
/		234,962,406 A

FCLGA		Flip Chip Land Grid Array
Bumping		FC UBM Ŵ

هدد

هم

Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.

فخ سم

1

غى Ռ غى

" " Ռ 2011

Ռ غى " "

ط صر تجى Ռ

2012 Ռ Ռ

Ռ غى

Ռ

غى

يح

FC FC

غى Ռ غى

هم

Ռ

هم

QFII هم

هم

تن جم

غى جم

غى

يخ

كل

سم بر ني

2013 11 28

20

20 20

5.32 20 ÷

/

9.5 هبه FC

2013 11 27

Ռ

فی جه فی

Ռ فی

Ռ ۹

عم LED

جم عج ؛

فى فى

فى سم جم

فى 2012 8,558.6 2012 3,800 2005 عج

ر فى 59.26% عج عج

فى 2,158.45 2012 985.78 2005

عج فى فى جم سم

AP هم

فى

2 FC عج

2008 فى

2010 فى

فى فى هى

2012 511.6 2006 ر

1,035.67

I/O ∩

عج

هج FC جم I/O

p

صر

يج FC

p FC FC

Yole Développement 2012 FC عج 200

2018 350 28nm IC DDR

2.5D/3D IC interposer FC

ﷺ ﷺ ﷺ

[illegible] 22P /MC0 /T>BDC BT/F2 12 T1322 081 0.02 0.r 0.342186w2 75251-40CD1>41118A7.861-403EE>

1

2012

546 68 صر 471 فی

TSV SiP لم

Cu Pillar Bumping FCBGA 50 m تجی MEMS

FC جه

FC

فی ‘‘ ر فی

”

2 p p

فی

همه یحه

Bumping 8 ″ 12 ″ WLCSP p 3P3M همه BGA

12 ″ 40nm low-k BGA p

جه FC Flip Chip on L/F FCLGA ∩ FCBGA p کا

Bumping Flip Chip

5

116,700 ر p

12,828 ھی

2010 2011 2012 2013 9

46.47% 57.50% 62.98% ∩ 65.58% 9

∩

ج

∩

3

2010 2011 2012

2013 1-9 9,032.43 10,015.91

15,725.51 ∩ 13,486.27

ج

ني

p

؛

كا

ก

؛

” FC هجـ 9.5 “

p سمعج

؛

ني

ة ئ

جم ة كا

جم ก

يخ

جم

هم يج عج

فى

فى عج

يج ؛ يج

جم

نعي

16.28% يخ

يخ 5% جم كلا

سم

ثة

ن

جم

2008 ؛

يج ؛ يج عج

ɒ صر ɒ

عج

18 ɒ Ω

Π Ŭ DZ ⁎ ɒ DZ DZ DZ ħ عج DZ ϰ ϧ

Ů جم ئم ك ‖

فى

3 ∩ ت

∩ سم

“

هم

تن

1

îÁ/ÂÅÃCx\4R • 11bdv²¯á k 3 ‡ @ b À

جم يج

نمي Ռ

كلا

1

2

هم هى

؛

يج جم

Ռ ՆՆ Ռ

Ռ

Ռ

Ռ

Ռ

هم هى جم

جم

2/3

Ռ ՆՆ Ռ

”

ऽ

3

2010 2012

2012	0.00	1,041.00	-
2011	0.00	6,731.71	-
2010	5,118.80	20,771.21	24.64%
ऽ			**9,514.64**
ऽ			**53.80%**

“ ”

يج

جم Ռ

هم يج Ռ

هى

Ռ

فى جم

هى Ռ

Ռ جم

Ռ

هى 2015- 2013

جم 1

جم 2

4 جم

2

نعي هى

1 هى

جم ( )